

上海盛剑科技股份有限公司

关于2024年度担保额度预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称“盛剑半导体”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过人民币 8,000.00 万元（本金，含等值外币）；截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 13,813.91 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保额度预计概述

为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，2024年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子有限公司、北京盛剑微电子技术有限公司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电子有限公司、湖北盛剑设备有限公司提供担保额度合计不超过人民币110,000.00万元（含等值外币）。

提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本次担保额度预计自股东大会审议通过之日起生

效至2024年12月31日止。具体担保期限以实际签署协议为准。为便于相关工作的开展，授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

公司于2023年12月28日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，以及于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》。保荐机构对上述事项无异议。具体内容详见公司于2023年12月30日以及2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》及《2024年第一次临时股东大会决议公告》等相关文件。

二、担保进展情况

2024年12月23日，公司与上海银行股份有限公司市北分行（以下简称“上海银行市北分行”）签订《最高额保证合同（适用于单位提供保证）》【ZDB23024005601】（以下简称“本合同”）。本合同约定，公司为盛剑半导体与上海银行市北分行在2024年12月23日至2027年11月28日期间所订立的一系列（含一种或数种的联合）综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等业务项下具体合同（以下简称“主合同”）所形成债权本金（包括借款本金、贴现款、垫款等）承担连带责任保证。担保的最高主债权限额为人民币8,000.00万元。盛剑半导体的其他股东方未提供担保。本次担保事项在上述审议额度范围内，无需另行审议。

三、被担保人基本情况

- （1）公司名称：上海盛剑半导体科技有限公司
- （2）成立日期：2021年12月27日
- （3）法定代表人：张伟明
- （4）注册资本：11,750.00万人民币
- （5）住所：上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2450室

(6) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售，普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；环境保护专用设备销售；机械设备租赁，以下限分支机构经营；半导体器件专用设备制造，电子专用设备制造，工业自动控制系统装置制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用零部件制造，机械零件、零部件加工，环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(7) 主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），总资产合计为36,536.63万元，净资产合计为13,430.11万元，资产负债率为63.24%；2023年（经审计）营业收入为9,047.91万元，净利润为-460.54万元。

截至2024年9月30日（未经审计），总资产合计为49,572.55万元，净资产合计为14,238.71万元，资产负债率为71.28%；2024年1-9月（未经审计）营业收入为9,134.86万元，净利润为791.60万元。

(8) 被担保人与公司的关系：被担保人为公司控股子公司。

2023年8月3日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司盛剑半导体通过增资扩股方式引入外部投资者上海榄余坤企业管理中心（有限合伙）（以下简称“榄余坤企管”）及盛剑半导体员工持股平台A（拟设立）、盛剑半导体员工持股平台B（拟设立）（后两者合称“盛剑半导体员工持股平台”，公司全资子公司上海盛剑芯科企业管理有限公司拟作为两家员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人）。本次外部投资者榄余坤企管及盛剑半导体员工持股平台拟合计对盛剑半导体投资金额为4,900万元（对应新增注册资本1,750万元，剩余3,150万元计入盛剑半导体资本公积）。增资完成后，公司持有盛剑半导体的直接持股比例为85.11%，并通过盛剑半导

体员工持股平台控制盛剑半导体 9.96%的股权，其余股权由本次引入的外部投资者持有。2023 年 12 月 28 日，盛剑半导体完成本次增资的工商变更手续，并取得上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 5 日、2023 年 9 月 9 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-059、2023-063、2023-088）。

四、最高额保证合同的主要内容

1、保证人：上海盛剑科技股份有限公司

2、债权人：上海银行股份有限公司市北分行

3、债务人：上海盛剑半导体科技有限公司

4、主债权范围：上海银行市北分行与盛剑半导体在2024年12月23日至2027年11月28日期间所订立的一系列主合同所形成的债权本金（包括借款本金、贴现款、垫款等）。

本合同生效前已存在的编号为230230063的《综合授信合同》、编号为23023006501的《银行承兑汇票承兑合同（资产池专用）》项下债权应当纳入本合同担保的债权范围。

5、保证担保范围：本合同主债权涉及的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失；保证担保的范围若超出本合同规定的最高主债权限额，保证人仍应承担担保责任。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收

回债权的，保证人应当提前承担保证责任。

8、担保的最高主债权限额为8,000万元人民币。

9、本合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签章并加盖公章或合同专用章后生效。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足盛剑半导体业务发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。因此，盛剑半导体的其他股东未提供担保。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额、余额分别为110,000.00万元（即2024年度担保预计总额）、20,112.20万元，分别占公司最近一期经审计净资产的69.09%、12.63%。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司或全资孙公司。

截至本公告披露日，上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2024年12月25日